

روش های اتصال قطعات به برد در الکترونیک

بر حسب پایه, قطعات, به انگلیسی component ها در الکترونیک به دسته های مختلف تقسیم می شوند.

(<https://titoma.com/wp-content/uploads/2019/11/Soldering-Technologies-SMT-Through-hole-GBA.png>)

روش های اتصال

بر حسب چگونگی اتصال, چندین روش برای اتصال قطعات وجود دارد.

THT

تی اچ تی, مُخَفَّف through-hole technology, یک روش قدیمی برای اتصال قطعات به برد با لحیم از طریق سوراخ روی آن ها می باشد.

SMT

اس ام تی, مُخَفَّف surface mount technology به معنای تکنولوژی نصبِ سطحی است که در آن component ها بر سطح برد بدون سوراخ لحیم می شوند.

BGA

انواع قطعات

SMD

قطعات SMD قطعاتی با پایه های بسیار کوتاه هستند که به صورت مستقیم به روش SMT مخفف surface mount technology به سطح board متصل می شوند.

DIP

قطعات دی آی پی یا DIP مخفف dual in-line package قطعاتی با ۲ پایه بلند و موازی به هم هستند که به صورت THT مخفف through-hole technology, با پایه های خود, به سوراخ های دریل شده بر سطح bord متصل می شوند.